

## Y-C11-DEV数据手册

### 产品介绍

Y-C11-DEV 是基于 Jetson ORIN NX 和 ORIN NANO 模块驱动的 Plink AI 开发系统。全板器件均采用宽温型号，主要接口进行了静电安全保护设计，采用了高可靠性的电源应用方案，输入电源具有过压与反极性保护功能，具有丰富的对外接口。还可通过 1 个 MiniPCIe 连接器（含 USB2.0 及 PCIe X1 信号）搭载上百种功能模块，实现系统功能的进一步扩展。Y-C11 载板的 M.2 B key 槽位可直接搭载 4G/5G 通信模块，载板带有一个 Nano SIM 卡槽。独立的双千兆网口均可扩展 POE 供电支持。

### 产品特性

- 4 x USB3.0 TypeA 连接器
- 1 x Micro USB 连接器（用于烧录系统）
- 2 x 千兆以太网（10/100/1000 BASE-T）RJ45 连接器(可扩展支持 POE 供电)
- 1 x HDMI TypeA 连接器
- 1 x Nano 型 SIM 卡连接器
- 1 x 全长 MiniPCIe 连接器
- 2 x M.2 2242 M key 槽位
- 1 x M.2 3050 B key 槽位（可扩展 4G/5G 通信模块）
- 2 x 4 Lane MIPI 相机接口 FPC 连接器
- 1 x 3.3V RTC 供电接口
- 1 x 风扇控制接口（12V）
- 1 x 收发器的 CAN 总线接口
- 40pin(2x20) 2.0mm 间距多功能扩展插针连接器（含 4xGPIO, 2xI2C, 2xSPI, 1xI2S, 1xUSB2.0, 2xUART）
- 上电自动开机
- 防脱落电源接线端子
- 板卡尺寸：120mm\*102mm\*36mm
- 电源输入：DC +12V ~ +24V
- 工作温度：-25 ~ +60℃
- 重量：188g



订货型号	参数信息	散热方式
Y-C11-DEV	内置 Jetson ORIN NANO 4G 模组	主动散热
Y-C11-DEV	内置 Jetson ORIN NANO 8G 模组	主动散热
Y-C11-DEV	内置 Jetson ORIN NX 8G 模组	主动散热
Y-C11-DEV	内置 Jetson ORIN NX 16G 模组	主动散热